

# Pressa A Caldo Sotto Vuoto Automatica Da 15 Tonnellate Con Piastre Riscaldate 200X200 Mm E Raffreddamento Ad Acqua

Numero articolo: XP33



## introduzione

Scopri la pressa a caldo sotto vuoto automatica da 15 tonnellate di KINTEK: piastre riscaldate 200x200 mm (fino a 500 °C), controllo PID preciso, raffreddamento ad acqua e camera in acciaio inox SUS 304 per lavorazioni sotto vuoto o gas inerte: ideale per celle a bustina per batterie, laminazione di polimeri e legame per diffusione.

[Ulteriori informazioni](#)

Applicazione	Descrizione	Vantaggio chiave
Laminazione di celle a bustina per batterie	La laminazione di celle a bustina per batterie agli ioni di litio o allo stato solido richiede pressione e calore uniformi per legare gli strati senza danneggiare l'elettrolita. La capacità di vuoto rimuove umidità e gas, prevenendo la delaminazione e prolungando la durata della cella.	Elimina la delaminazione, migliora la conducibilità ionica e prolunga la durata del ciclo.
Laminazione di film polimerici	Lamina fogli di polimero o film compositi per incapsulamento elettronico, imballaggi medicali o display flessibili in condizioni controllate di temperatura e pressione.	Produce legami senza bolle e ad alta trasparenza con un controllo preciso dello spessore.
Legame per diffusione	Unisce metalli, leghe o ceramiche a temperature elevate sotto alto vuoto senza fusione, creando legami per diffusione atomica.	Ottiene interfacce ad alta resistenza e prive di pori, ideali per scambiatori di calore e dispositivi microfluidici.
Compattazione e sinterizzazione di polveri	Comprime polveri di metallo o ceramica in uno stampo sotto vuoto e calore per formare pellet o preforme dense.	Aumenta la densità, riduce la porosità e migliora le proprietà meccaniche ed elettriche.
Polimerizzazione di materiali compositi	Polimerizza compositi avanzati rinforzati con fibre con profili precisi di pressione e temperatura in atmosfera inerte.	Ottimizza la reticolazione, previene l'ossidazione e garantisce laminati senza vuoti.
Assemblaggio di elettronica flessibile	Lamina e incapsula circuiti flessibili, display OLED o sensori a film sottile con adesivi attivati dal calore sotto vuoto.	Mantiene l'allineamento, elimina i difetti da degassificazione e protegge i componenti sensibili.

Specifiche	Valore / Dettagli
Modello	XP33
Pressione di lavoro massima	≤ 15 Tonnellate (150 kN)
Temperatura di lavoro della piastra	Temperatura ambiente - 500 °C, touchscreen PID programmabile
Potenza di riscaldamento	3000 W
Dimensioni piastre	200 mm × 200 mm
Apertura piastre (intervallo)	50 mm
Pompa per vuoto inclusa	Pompa per vuoto a palette (standard)
Livello di vuoto (relativo)	< -0.1 MPa
Materiale camera	Acciaio inox SUS 304

Specifica	Valore / Dettagli
Compatibilità con gas atmosferici	Azoto (N <sub>2</sub> ) / Argon (Ar)
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento ad acqua circolante (entrambe le piastre)
Dimensioni esterne	650 × 492 × 725 mm
Peso netto	235 kg
Alimentazione	AC 220V / 50Hz, Monofase